证券代码：688380 证券简称：中微半导

**中微半导体（深圳）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2024-002

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者来访类别 | ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议□ 媒体采访 □ 业绩说明会□ 新闻发布会 ☑ 路演活动□ 现场参观 □ 其他 （线上调研） |
| 参与单位名称 | 中信证券、美银证劵、锦田投资、中保投资、辰星投资、中金富泰、富安时代、北京世纪金沙江、环球港湾、蓝海基金、招商证券BARCLAYS；ARTISAN PARTNERS LP；COLORADO PERA；POLAR CAPITAL LLP；SCGE MANAGEMENT LP；WALLEYE CAPITAL(UK) LIMITED |
| 时间 | 2024年3月8日、12日 |
| 地点 | 公司、策略会现场 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务总监：吴新元 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、公司基本情况、产品市场和未来发展情况**公司是一家以MCU为核心的平台型芯片设计公司，专注芯片设计、研发与销售，采取Fabless模式经营，将所有的晶圆生产、大部分封装测试业务委外代工进行；公司主要产品包括8位及32位MCU、SOC、ASIC等芯片和功率器件，产品广泛应用于消费电子、家用电器、工业控制和汽车电子等领域；公司行业地位逐步提升，产品出货量逐年攀升，2023年出货量近18亿颗，创造历史新高；随着高成本库存的消耗和市场需求复苏，去年四季度以来，公司出货量持续上升，产品毛利率触底反弹，公司盈利能力增强。公司始终坚持以MCU为核心，围绕智能控制器所需核心芯片，打造包括MCU、信号链、电源、通信、功率驱动、软件算法等完整的设计能力，力求为智能控制器提供一站式整体解决方案；坚持两手抓，一手抓高强度研发投入，积极布局新产品研发、老产品迭代和新领域拓展，一手抓品质流程和品牌建设，产品应用坚定不移从小家电向大家电发展、从消费电子向工业控制和汽车电子迈进，客户结构从小客户向品牌大客户转变，逐步巩固和扩大行业优势。由于国家的产业政策支持,产品市场空间广阔,公司管理层对公司的长期发展前景看好。1. **交流问答**

**1、公司一季度情况和年度预期如何？**答：公司持续去年四季度以来的增长势头；随着消费需求复苏、国家产业政策的刺激、公司高库存产品的有效消耗和新产品的推出，2024年公司营收和盈利可望实现增长。1. **公司上年度销售量达到18亿颗，说明公司市占率得到提升，请拆分一下产品结构？**

答：我们按照MCU、ASIC和功率器件来拆分，2023年的18亿颗出货量中，MCU近14亿颗、各类ASIC芯片大概3亿颗、功率器件近1亿颗，而MCU中8位机12亿多颗、32位机1亿多颗。1. **公司车规级产品研发和推广情况如何？**

答：汽车电子市场是公司布局的重要发展方向。车规级产品的研发也是公司重要的募投项目，去年公司车规级产品研发得到有效实施，多款车规级产品实现量产，车规产品阵列得到扩充，产品更加丰富，目前量产料号有20多款；通过一年多的推广，去年下半年以来，车规级产品实现稳定批量出货，期待今年车规级产品的营收有较大的突破；同时公司已经通过了SGS的ISO 26262的安规认证，标志着建立了符合汽车功能安全最高等级“ASIL-D” 级别完整的产品开发流程体系，助力公司未来在汽车电子领域高质量发展。1. **公司一直注重测量类产品的研发，目前市场推广情况如何？**

答：公司高精度测量类产品从性价比方面还是具有优势的，通过去年的推广，已经取得一些市场突破。新年度，这方面的增长值得期待。1. **谈谈公司电机控制业务发展情况？**

答：电机控制是MCU的一个重要应用方向，公司2018年布局电机控制产线，提供包括主控MCU、驱动和电机控制算法一体的解决方案。自2019年该产线实现营收以来，该产品线稳步增长，成为公司的第三大营收产线。去年公司推出了多款电机SOC产品，电机应用团队得到充实，团队服务能力有较大提升，预计今年该产线的业绩会有较大增长。1. **公司主要代工厂商？**

答：公司晶圆代工主要在华虹半导体和格罗方德公司，封测代工主要在华天科技、华润安盛、利扬芯片、伟测科技等。1. **晶圆代工厂选择的原则？**

答：首先看厂方的工艺是否满足产品性能、品质要求，其次是看性价比。1. **公司产品料号有多少？**

答：公司产品累计料号有1200多个，在售料号600-700个。1. **经销和直销占比？**

答：从营收来看，6成营收来自经销，4成来自直销。1. **公司的ASIC芯片有哪些？**

答：主要有高精度ADC、显示驱动、栅极驱动、电机驱动、触摸、线性稳压器等芯片。 |